

<<高密度封装基板>>

图书基本信息

书名：<<高密度封装基板>>

13位ISBN编号：9787302063865

10位ISBN编号：7302063869

出版时间：2003-9

出版时间：清华大学出版社

作者：田民波 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<高密度封装基板>>

### 内容概要

本书从印制线路板和微电子封装的基本概念入手，针对高密度多层基板，详细讨论了制造工艺、相关材料及应用等各个方面的内容。

主要包括印制线路板概述、高密度电子封装、无机封闭基板、高密度封装基板及其新课题、封装用一般有机基板材料、带载型封装用挠性基板材料、封装用积层板基材、高密度互连多层板芯制造技术、高密度互连积层板制造技术、特性阻抗和集成元件板等。

本书适合于微电子、化工、材料、电子元件器件、信息、通信、计算机、机械、塑料加工等各个领域的学生、教师和工程技术人员参考使用。

<<高密度封装基板>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>